



2026 年 8 月 6 日

各位

会 社 名 ワイエイシイホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 百瀬 武文  
(コード番号 6298 東証プライム)  
問合せ先 経営戦略本部経営推進部 村澤 賢雄  
(TEL：042-546-1161)

## 当社子会社 株式会社ワイエイシイデンコーが「サーモテック 2026」に出展

### 次世代半導体市場向け新製品『Under 6 inch 小径ウエーハ用加熱装置』を初公開

ワイエイシイホールディングス株式会社（東証プライム市場：6298）は、100%子会社である株式会社ワイエイシイデンコーが、2026 年 9 月 9 日から 11 日まで東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級の熱技術専門展示会「サーモテック 2026（第 9 回国際工業炉・関連機器展）」(<https://thermotec.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html>)に出展し、新開発の\*\*「Under 6 inch 小径ウエーハ用加熱装置」\*\*を初公開することをお知らせいたします。

近年、EV、AI データセンター、再生可能エネルギー分野の拡大を背景として、SiC（炭化ケイ素）や GaN（窒化ガリウム）などの次世代パワー半導体市場が急速に成長しております。これらの開発現場では、研究開発や試作工程において小径ウエーハを対象とした高精度な熱処理技術への需要が高まっています。

今回発表する「Under 6 inch 小径ウエーハ用加熱装置」は、6 インチ以下の小径ウエーハに特化した加熱プラットフォームとして開発したもので、高い温度均一性と安定した熱処理性能を実現し、大学・研究機関・半導体メーカー・センサーメーカーにおける研究開発から少量生産まで幅広い用途への対応を可能とします。

当社グループはこれまで半導体製造装置分野において培った熱制御技術や自動化技術を活用し、成長が見込まれる化合物半導体や先端材料分野への展開を進めております。本製品の投入により研究開発市場への提案力を強化するとともに、将来的な量産設備への展開を視野に入れ、新たな事業機会の創出を目指してまいります。

サーモテック 2026 では、本製品を通じて国内外の研究機関、半導体メーカーおよび関連企業に対する積極的なマーケティング活動を展開し、中長期的な受注拡大および企業価値向上に取り組んでまいります。

**<出展概要>**

**展示会名**

サーモテック 2026（第 9 回 国際工業炉・関連機器展）

**会期**

2026 年 9 月 9 日（水）～11 日（金）

**会場**

東京ビッグサイト 南ホール 1    ブース：S1-B005

**出展会社**

株式会社ワイエイシイデンコー

**<お問合せ先>**

ワイエイシイデンコー社への製品に関するお問合せ

⇒ <https://www.yac-denko.co.jp/contact/>

以上